



SDK

**MLCC<CC&HTCC
Application Solutions**

MLCC<CC&HTCC应用解决方案

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
Jiangsu Sidike New Materials Science and Technology Co., Ltd.

**Embedded Development,
Inspired Innovation.**

嵌入式研发，协同式创新。

www.sidike.com



目录/Contents

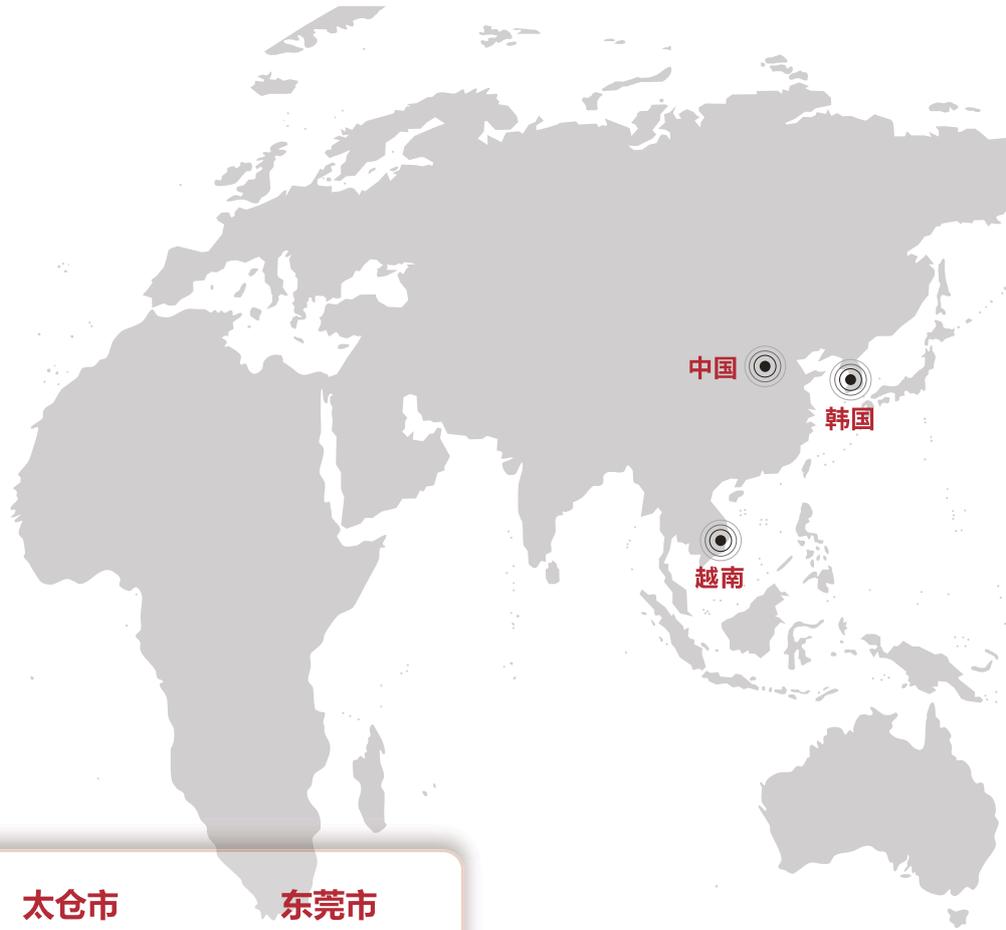
1	公司简介	02
2	产品概况	04
3	MLCC 离型膜	06
4	LTCC/电感/陶瓷基片 离型膜	08
5	MLCC 热失粘胶带	10
6	MLCC UV失粘胶带	11
7	晶片贴合A、B耐热胶带	12

中国领先的 功能性涂层复合材料及胶黏剂供应商

国内领先规模化生产基地



斯迪克是一家专注于光学级高端膜材的高新技术企业，与同行业全球标杆企业一样具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商。产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴电子产品以及新能源汽车等。



江苏省泗洪经济开发区

制造基地
苏北营销中心
苏北研发中心

太仓市

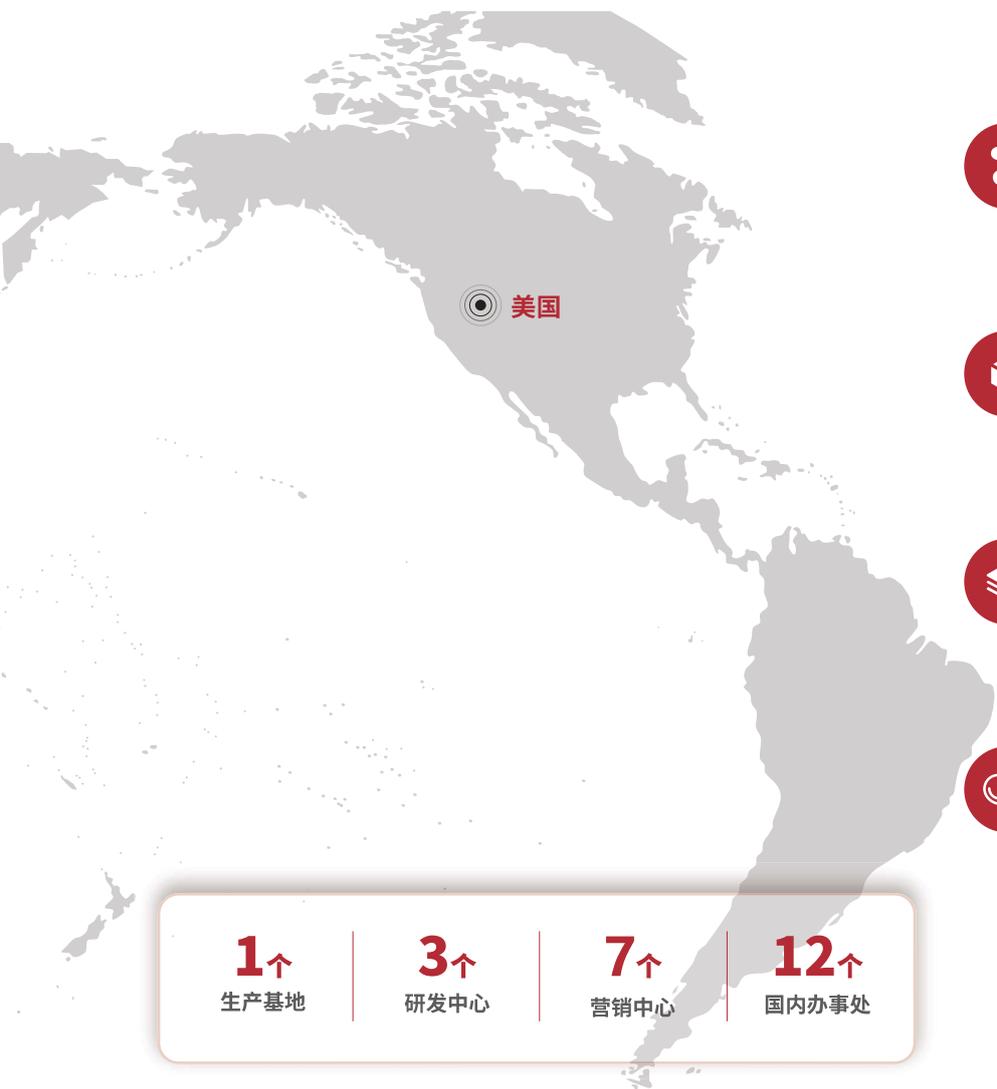
华东营销中心 华东研发中心

东莞市

华南营销中心

重庆市

西南营销中心



高分子聚合

- 少数具备高分子材料合成能力的企业；
- 自主研发、设计、制造高分子材料；
- 具备依据客户需求开发差异性产品的技术基础。



功能结构设计

- 通过不同涂层、基膜的组合，有效实现产品性能；
- 以市场为导向，用有效产品结构设计解决客户问题。



涂层配方优化

- 决定具体产品性能的重要技术内容；
- 合理的配方设计以提高产品的功能性及差异化；
- 实现耐高温、阻燃、绝缘、导电、导热等性能。



产品精密涂布

- 18年实践积累大量的经验与数据；
- 生产工艺达到更高精度，更高一致性以及更高表现质量；
- 薄膜表面处理，涂层固化及其他技术指标以满足客户需求。

1↑
生产基地

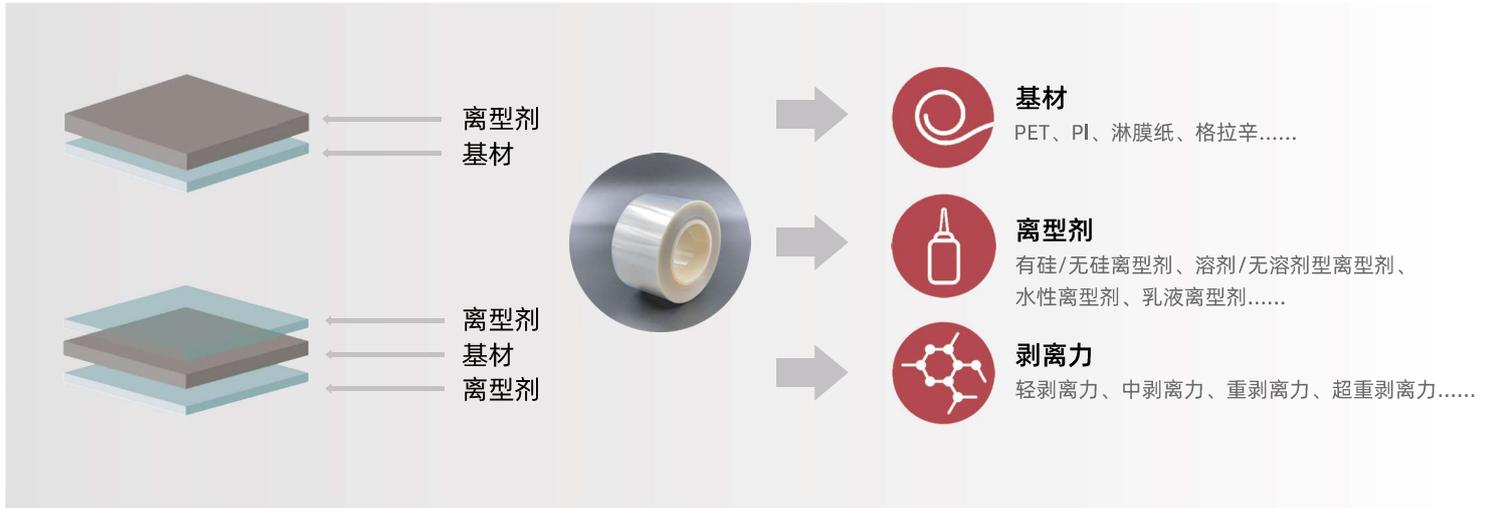
3↑
研发中心

7↑
营销中心

12↑
国内办事处

SDK离型材料概况

OVERVIEW OF SDK RELEASE MATERIALS



核心优势

CORE ADVANTAGES

基材
先进的自拉膜产线
厚度覆盖4.5-350um

离型剂
定制化配方
硅/非硅
溶剂/水性

涂布
日本进口
涂布产线

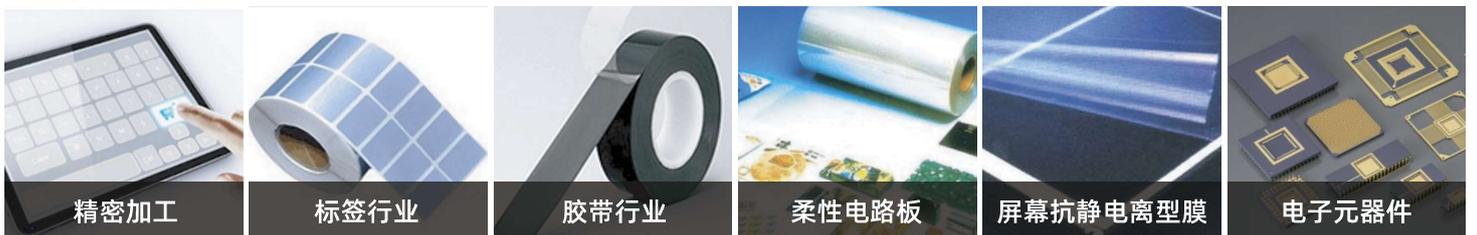
环境
百级无尘室

研发能力
校企合作
与苏州大学合作
开发离型剂合成

应用场景

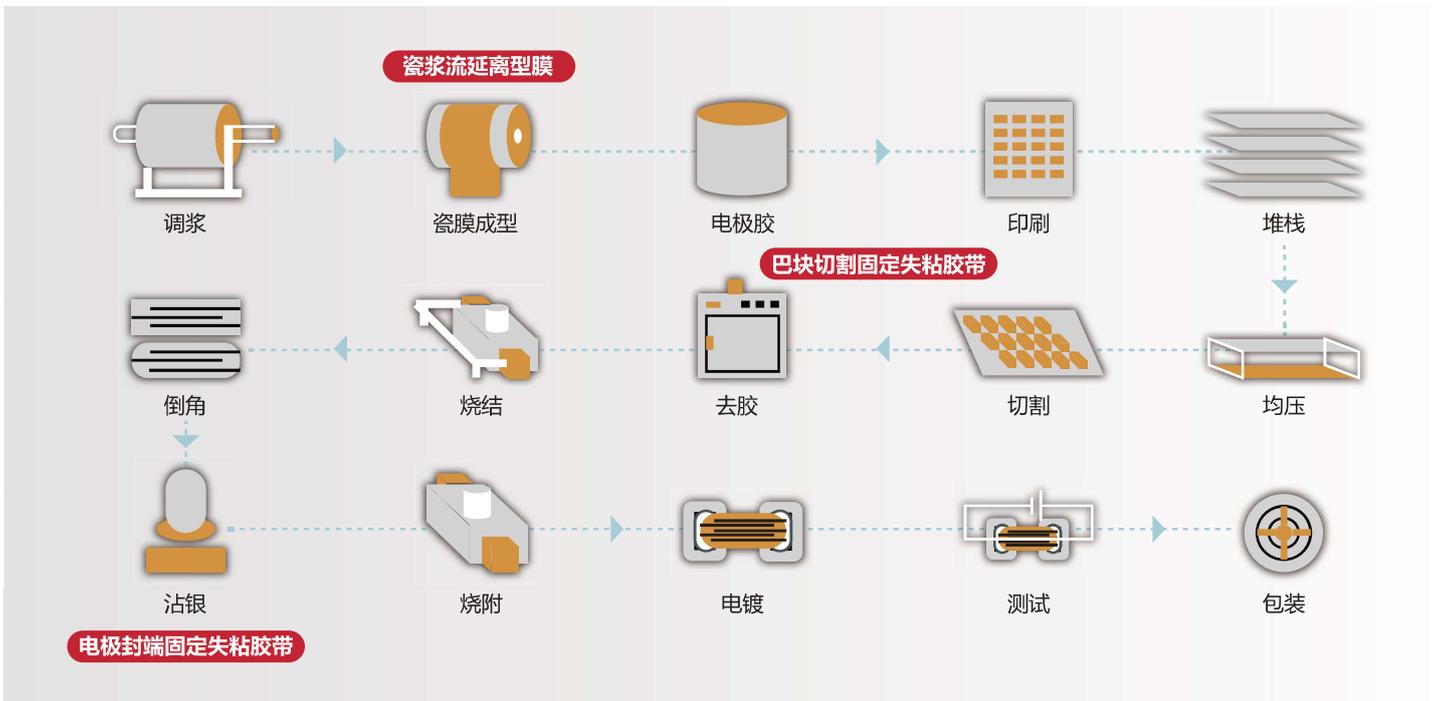
APPLICATION SCENARIO

主要用于精密加工、标签行业。胶带行业、柔性电路板、激光防伪、防水材料、医药、电子元器件等行业。



MLCC制程中产品应用

PROCESS



研发设备

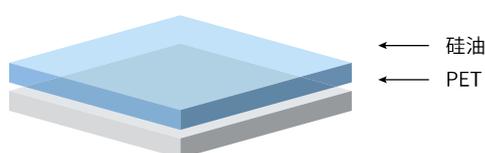
R&D EQUIPMENT



产品特点

- PET自拉膜控制基膜粗糙度/拉伸强度;
- 定制化离型剂适配不同瓷浆体系;
- 高性能配方确保离型力、残余、固化控制;
- 精密涂布确保涂层均一、膜面无欠陷;
- 无尘室管理制造，产品洁净度高。

产品结构

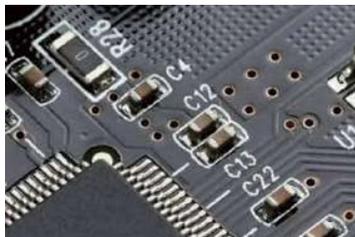


产品规格

等级	流延膜厚 (um)	离型剂	颜色	厚度 (um)	厚度极差R (Max-Min) (um)	常温 24h 剥离力 (gf/inch, tesa7475)
超高端	<1.5	硅系/非硅	透明	30	≤0.3um	10~20
						20~30
						30~50
高端	1.5~3.0	硅系/非硅	透明	30/25	≤0.5um	10~20
						20~30
						30~50
中端	3.0~6.0	硅系	透明	30/25	≤0.8um	500~1000 (日东31B)
						10~20
						20~30
普通	>6	硅系	透明	30/25	≤1.2um	30~50
				38	≤1.5um	11~20
						21~30
普通	>6	硅系	透明	50	≤2.0um	30~50
						11~20
						21~30
						50~80
						80~120
						120~200

产品用途

- 应用于MLCC陶瓷浆料流延成膜工艺中的高精度、洁净承载膜。

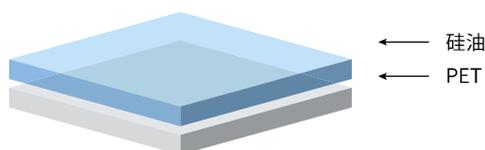


离型面粗糙度		热收缩率%(150°C 30min)		残余接着率 (日东 31B)	抗静电有无 (膜面绝缘阻抗Ω)	宽度 (mm)
Ra(um)	Rz(um)	MD	TD			
≤0.015	≤0.1	≤1.5	≤0.5	≥95%	可设定 (e ⁶ ~e ¹¹)	100~1000
≤0.015	≤0.1	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.015	≤0.1	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.020	≤0.3	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.020	≤0.3	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.020	≤0.3	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.020	≤0.3	≤1.5	≤0.5	≥95%		
≤0.030	≤0.6	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.030	≤0.6	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.030	≤0.6	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.030	≤0.6	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.045	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.045	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.045	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥92%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥90%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥90%		
≤0.050	≤0.8	≤1.5	≤0.5	≥85%		

产品特点

- PET自拉膜控制基膜粗糙度/拉伸强度；
- 定制化离型剂适配不同瓷浆体系；
- 高性能配方确保离型力、残余、固化控制；
- 精密涂布确保涂层均一、膜面无欠陷；
- 无尘室管理制造，产品洁净度高；
- 特殊的基材处理，确保热收缩低。

产品结构

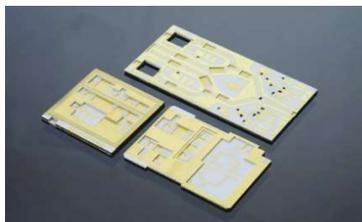
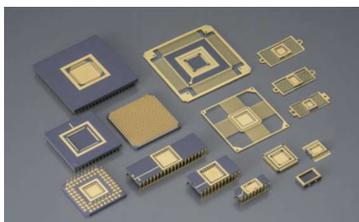


产品规格

等级	离型剂	颜色	厚度 (um)	厚度极差R (Max-Min) (um)	常温 24h 剥离力 (gf/inch, tesa7475)
高端	硅系/非硅	50	透明	≤2.0um	10~20
					20~30
普通	硅系/非硅	50	透明/白色	≤3.0um	10~20
					20~30
					30~50
					50~80
					80~120
		75/100/125	透明/白色	≤3.0um	120~200
					200~300
					300~500
					80~120
					120~200
					200~300
					300~500

产品用途

- 应用于LTCC，电感以及陶瓷基片陶瓷浆料流延成膜工艺中的PET基材精密离型膜。

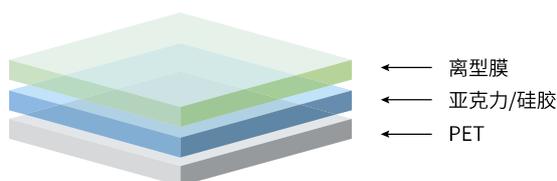


离型面粗糙度		热收缩率%(70°C 20min)		残余接着率 (日东 31B)	抗静电有无 (膜面绝缘阻抗Ω)	宽度 (mm)
Ra(um)	Rz(um)	MD	TD			
≤0.050	≤0.8	≤0.025	≤0.025	≥95%	可设定 (e ⁶ ~e ¹¹)	100~1000
≤0.050	≤0.8	≤0.025	≤0.025	≥95%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥92%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥92%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥92%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥90%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥90%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥90%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		
≤0.075	≤2.0	≤0.1	≤0.1	≥85%		

产品特点

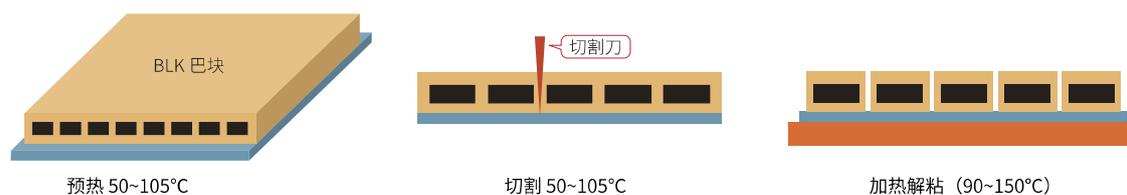
- 以普通胶带为基础，加入遇热解离成分，在外界温度高到一定程度下可自动减粘解离；
- 自有配方实现剥离力和解离温度的定制化；
- 覆盖PET/PI基材及多种厚度适合不同工况。

产品结构



产品用途

- 切割时（50~105℃）固定MLCC集成块，切割后升温解离使单个切块脱落。



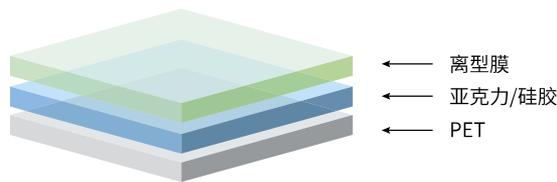
产品规格

基材	胶系	基材厚度 (um)	胶膜厚度 (um)	总厚 (不含离型膜) (um)	粘着力(SUS) gf/25mm				开始发泡温度 (°C)	最佳发泡温度 (°C)
					常温25°C	75°C粘性 (10min)	125°C粘性 (60min)	热发泡后		
PET	丙烯酸	75	60	135	700~800	80±20	-	0	90	110
PET	丙烯酸	100	50	150	400~600	150±20	-	0	75	95
PET	丙烯酸	100	50	150	120~150	100±20	-	0	120	140
PET	硅胶	100	50	150	2000~2500	100±20	50	0	120	145

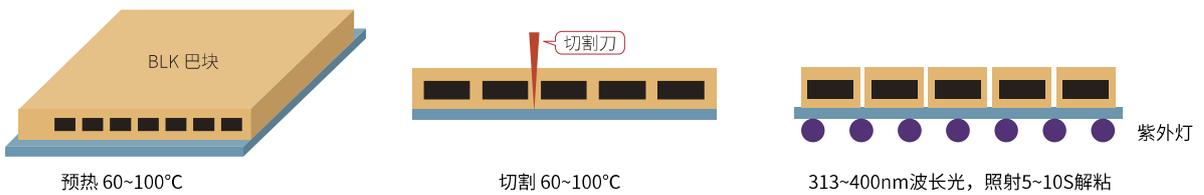
产品特点

- UV 减粘胶带采用特殊设计和配方，在受到紫外光辐射后可自动减粘，从粘贴表面脱离；
- 初始剥离力定制化配方匹配不同厚度巴块和切割尺寸；
- 5-10秒UV照射后快速失粘，省能源且可省节拍。

产品结构



产品用途



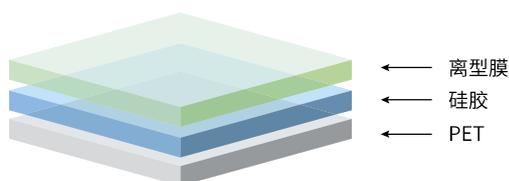
产品规格

基材	胶系	基材厚度 (um)	胶膜厚度 (um)	总厚(不含离型膜) (um)	粘着力(SUS) gf/25mm		发泡条件
					UV前	UV后	
PET	UV丙烯酸系	50	10	60	1300±200	<10	313~400nm
PET	UV丙烯酸系	75	25	100	800±200	<10	
PET	UV丙烯酸系	100	20	120	1600±200	<10	
PET	UV丙烯酸系	150	50	200	1400±200	<10	

产品特点

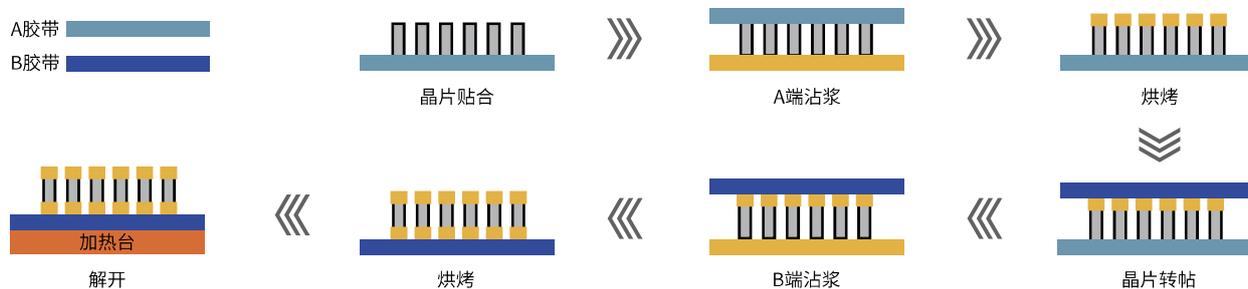
- 以PET基材基础，涂敷耐高温胶，并加入热膨胀发泡剂，在外界温度高到一定程度下可自动减粘解离；
- 自有配方实现剥离力和解离温度的定制化；
- 长时间耐120°C高温，无残胶，180°C~220°C易解开。

产品结构



产品用途

- 用于封端工序晶片贴合、烘烤、转贴、解开。



产品规格

类型	基材	胶系	基材厚度 (um)	胶膜厚度 (um)	常温剥离力 (gf/inch)	高温剥离力120°C 30min (gf/inch)	发泡温度 (°C)	发泡时间 S (加热平台)
A胶带	PET	硅胶	30/50/75/100	10±2	100~300	100~200	-	-
		硅胶	30/50/75/100	30±5	100~300	100~200	-	-
		硅胶	30/50/75/100	30±5	200~400	100~250	-	-
		硅胶	30/50/75/100	50±5	200~400	100~250	-	-
B胶带	PET	硅胶	30/50/75/100	30±5	400~600	200~400	180~220	20~60
		硅胶	30/50/75/100	30±5	600~800	300~500	180~220	20~60
		硅胶	30/50/75/100	50±5	400~600	200~400	180~220	20~60
		硅胶	30/50/75/100	50±5	600~800	300~500	180~220	20~60



江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

地址：中国江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号

电话：0527-8989 6660 传真：0527-8989 2222

www.sidike.com



扫码关注斯迪克集团
了解更多新材料解决方案